

第74期（2020年3月期）
第2四半期
〈4～9月〉
連結決算補足資料

2019年11月13日

株式会社 テクノ・セブン

<http://www.techno7.co.jp/>

（証券コード番号 6852）

【お問い合わせ先】

管理本部 IR担当

TEL 03-3419-4411（代表）

2020年3月期 第2四半期 連結業績概要



対前年同期比

売上高

1557百万円

170百万円増 (12.3%増)

- システム事業：官公庁関連の受注が堅調に推移したことにより、クラウド、IoTを中心としたIT基盤設計・構築サービス、組込み及び業務系アプリケーション開発の売上が拡大したため、システム事業の連結売上高は前年同期比で17.1%増加した。
- 事務機器事業：自社製品に加え協力メーカーの製品も含めて、自動紙折り機や3Dプリンタなど商品ラインアップを充実させ、更に消費税増税による主力製品タイムレコーダーの消耗品の駆け込み需要や、開発業務の受託など収益性の高い商品及びサービスを展開したため、前年同期比で1.7%増加した。
- 不動産事業：所有賃貸不動産の稼働率維持に努めたが、一部不動産の契約満了により連結売上高は前年同期比で0.8%減少した。

営業利益

180百万円

53百万円増 (41.7%増)

経常利益

183百万円

55百万円増 (43.8%増)

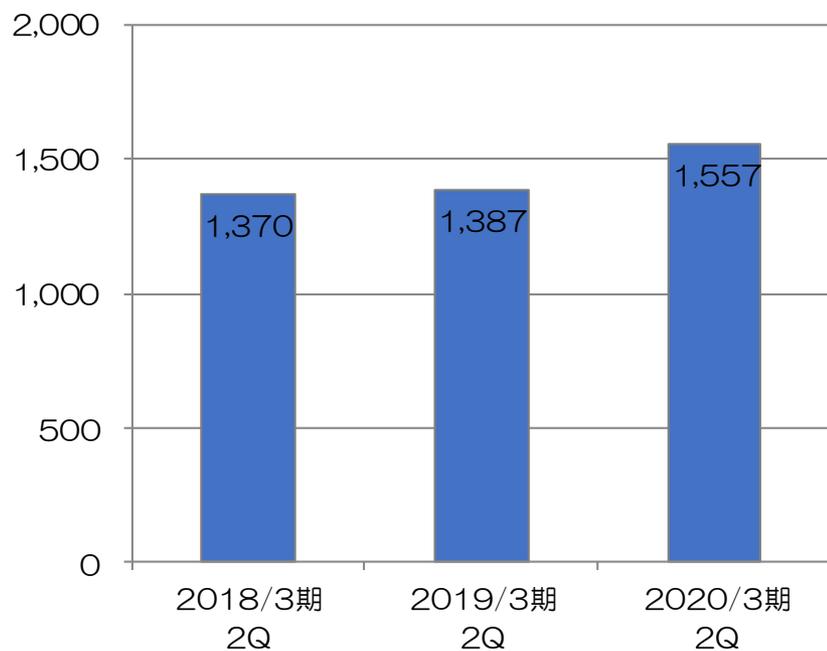
- システム事業：前年同期比で40.3%増加した。
- 事務機器事業：前年同期比で342.1%増加した。
- 不動産事業：前年同期比で10.4%減少した。

連結売上高・経常利益 業績推移

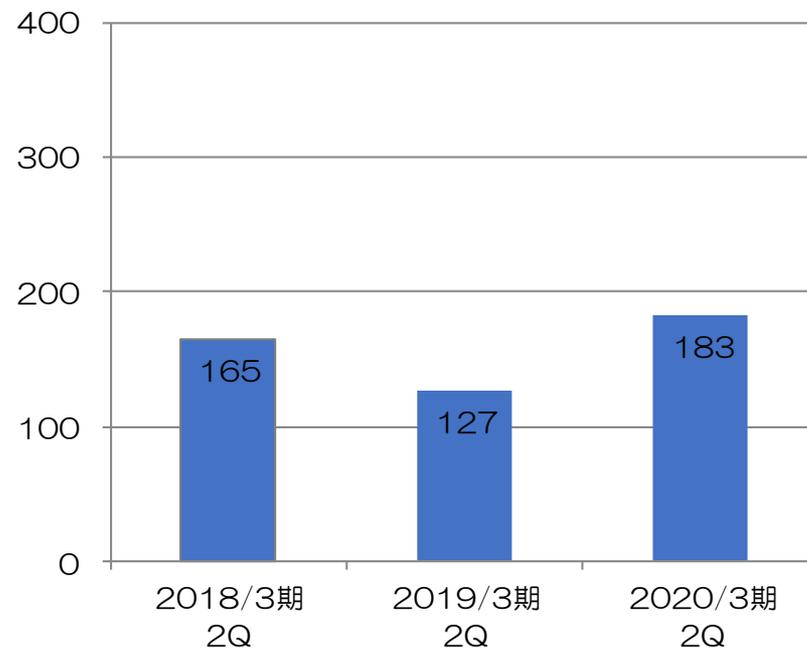


単位：百万円 （百万円未満切り捨て）

売上高



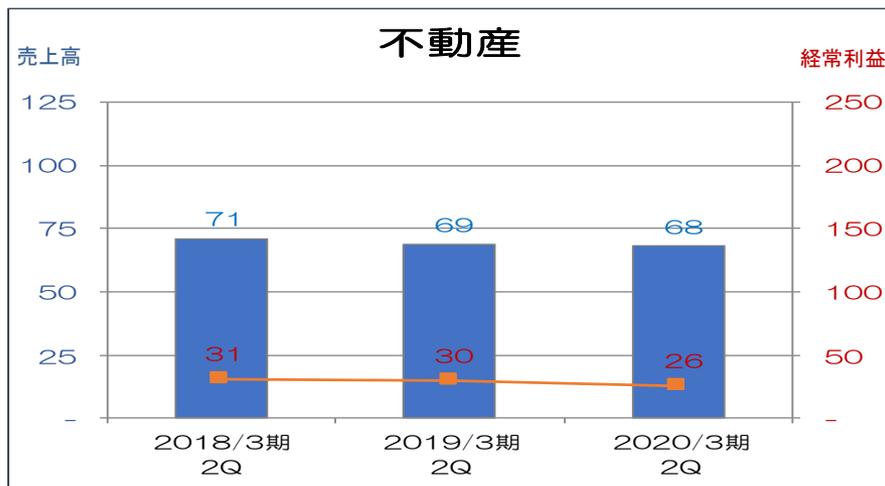
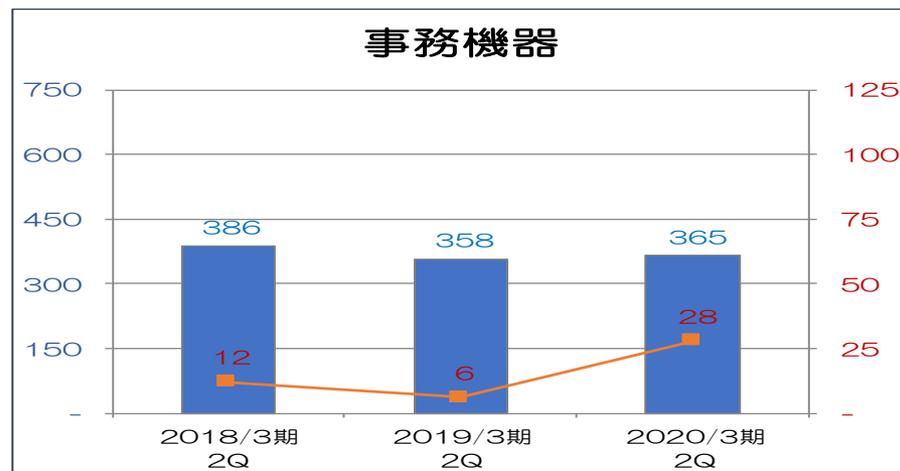
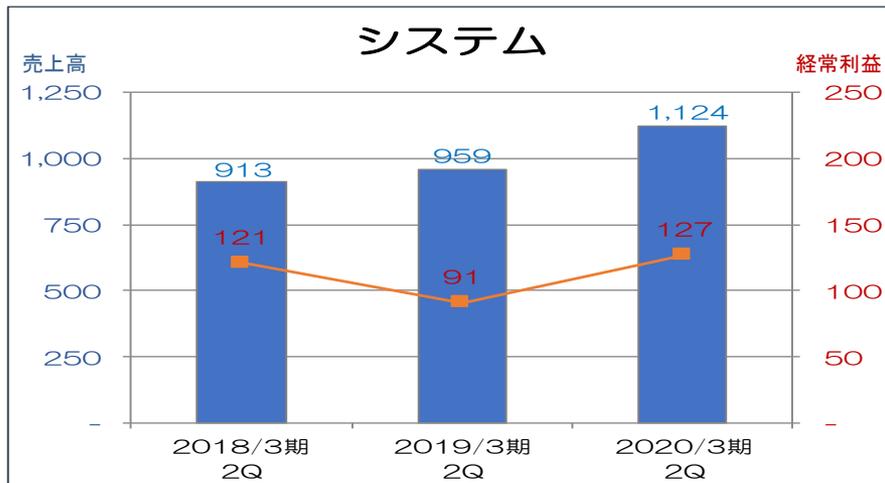
経常利益



事業別 連結売上高・経常利益推移



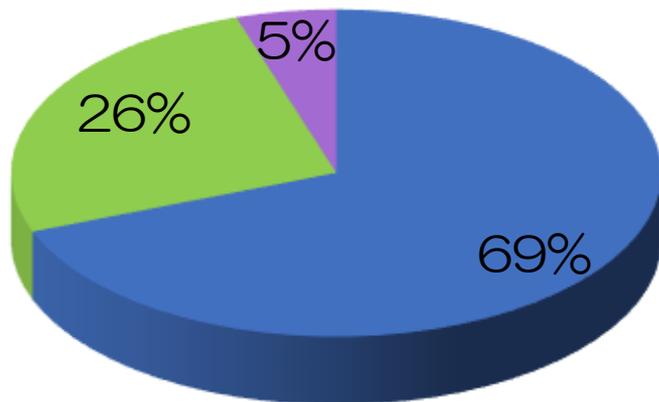
単位：百万円 （百万円未満切り捨て）



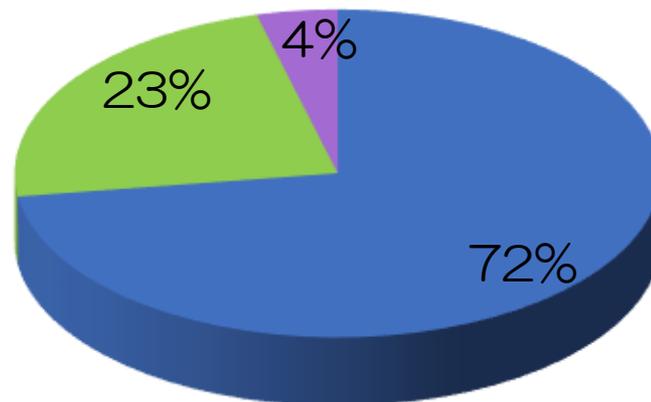
事業別 連結売上高 構成比



2019/3期 2Q



2020/3期 2Q



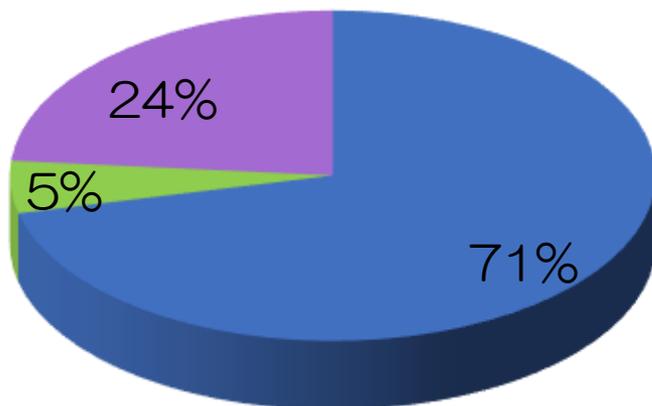
(百万円未満切り捨て)

単位：百万円	2019/3期 2Q		2020/3期 2Q	
	金額	構成比	金額	構成比
システム事業	959	69%	1,124	72%
事務機器事業	358	26%	365	23%
不動産事業	69	5%	68	4%
計	1,387	100%	1,557	100%

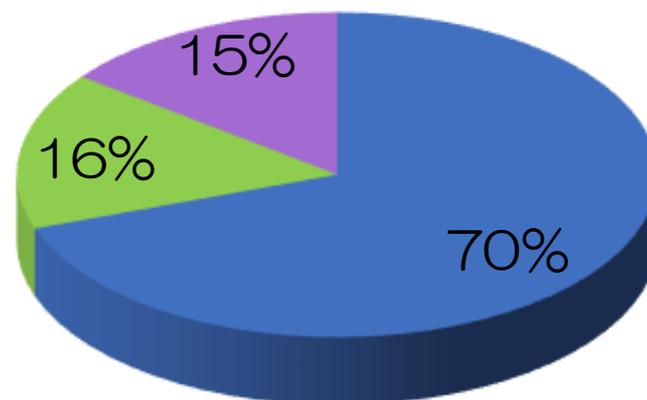
事業別 連結経常利益 構成比



2019/3期 2Q



2020/3期 2Q



(百万円未満切り捨て)

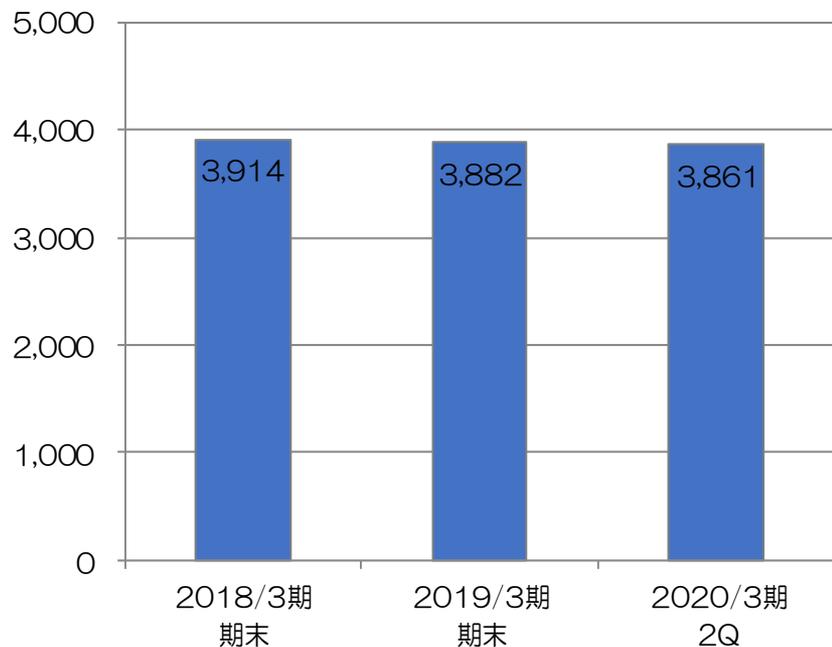
単位：百万円	2019/3期 2Q		2020/3期 2Q	
	金額	構成比	金額	構成比
システム事業	91	71%	127	70%
事務機器事業	6	5%	28	16%
不動産事業	30	24%	26	15%
計	127	100%	183	100%

連結総資産・純資産 業績推移

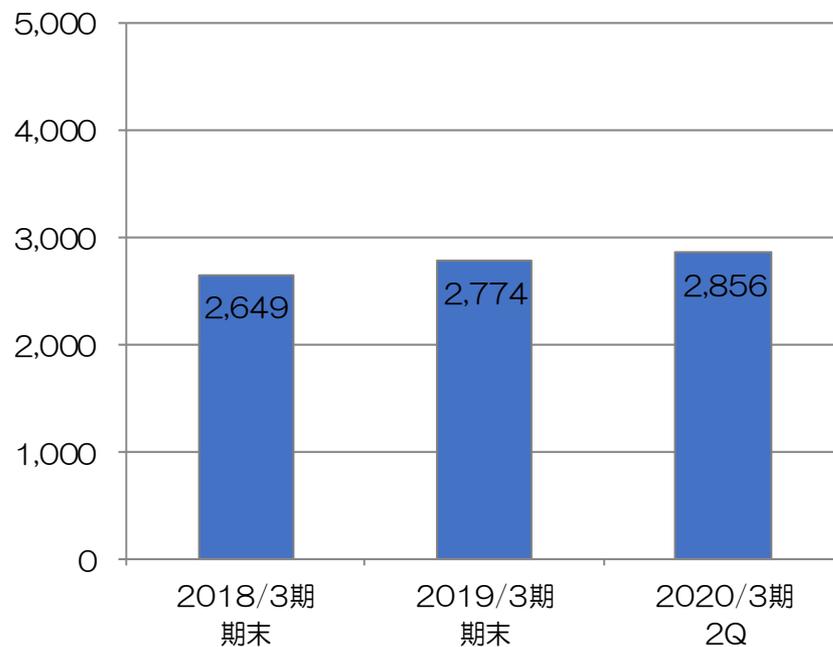


単位：百万円 （百万円未満切り捨て）

総資産



純資産



連結損益計算書の概要



百万円未満切り捨て

単位：百万円	第73期 (2019年3月期)		第74期 (2020年3月期)		増減額	増減率
	第2四半期		第2四半期			
	金額	売上比	金額	売上比		
売上高	1,387	100.0%	1,557	100.0%	170	12.3%
売上原価	1,010	72.8%	1,128	72.5%	118	11.8%
売上総利益	377	27.2%	428	27.5%	51	13.6%
販売管理費	249	18.0%	247	15.9%	△1	△0.8%
営業利益	127	9.2%	180	11.6%	53	41.7%
営業外収益	3	0.2%	5	0.4%	2	74.0%
営業外費用	3	0.2%	2	0.2%	△0	△8.2%
経常利益	127	9.2%	183	11.8%	55	43.8%
特別利益 又は 特別損失 (△)	△12	△0.9%	1	0.1%	13	n/a
税金等調整前当期純利益	115	8.3%	185	11.9%	69	60.3%
親会社株主に帰属する当期純利益	68	4.9%	118	7.6%	50	74.3%

連結貸借対照表の概要



百万円未満切り捨て

単位：百万円	第73期 (2019年3月期)	第74期 (2020年3月期)	増減額	増減率
	期末	9月末		
資産	3,882	3,861	△20	△0.5%
流動資産	1,433	1,454	21	1.5%
現金及び預金	848	874	26	3.1%
売掛債権	480	442	△38	△7.9%
棚卸資産	93	84	△8	△9.6%
その他	11	53	42	382.3%
固定資産	2,448	2,407	△41	△1.7%
有形・無形固定資産	2,020	2,017	△3	△0.2%
投資その他の資産	428	390	△38	△8.9%
負債	1,107	1,005	△101	△9.2%
流動負債	432	354	△77	△18.0%
買掛債務	106	90	△16	△15.7%
一年内返済予定長期借入金	100	19	△81	△80.9%
未払法人税等	48	63	14	30.1%
その他	176	181	5	3.0%
固定負債	674	650	△23	△3.5%
長期借入金	378	369	△9	△2.5%
その他	296	281	△14	△4.8%
純資産	2,774	2,856	81	2.9%
株主資本	2,569	2,834	264	10.3%
その他包括利益累計額合計	16	22	5	30.4%
非支配株主持分	188	-	△189	-
自己資本比率	66.6%	74.0%	7.4ポイント	

2020年3月期 通期 連結業績予想



第73期（2019年3月期）実績

単位：百万円	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株配当
実績	3,006	353	351	198	30円

第74期（2020年3月期）予想

単位：百万円	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株配当
予想	3,300	385	379	230	30円
増減率	+9.8%	+8.9%	+7.7%	+15.9%	—

参考資料

会社概要



商号	株式会社 テクノ・セブン
設立年月日	1950年4月28日（昭和25年4月28日）
資本金	1億円
代表者	代表取締役社長 齊藤 征志
本社所在地	東京都世田谷区池尻3-1-3 MUTOH池尻ビル
支店	東京・蒲田・蕨・横浜・新横浜・東戸塚・厚木・名古屋・京都・大阪
上場証券取引所	東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）（証券コード6852）
社員数	360名（連結）（2019年4月）
売上高	30.0億円（連結）（2019年3月期）
主要取引銀行	三菱UFJ銀行、りそな銀行
URL	http://www.techno7.co.jp/
連結子会社	株式会社テクノ・セブンシステムズ ニッポー株式会社

（2019年9月30日現在）

沿革①



- 1947年6月 東京都大田区に信陽工業(株)を創業、金属プレス加工業を開始
- 1950年4月 宝工業(株)に商号変更、改組
- 1956年2月 サーミスタ温度計の製品化に成功
- 1960年11月 大阪市北区に大阪営業所を開設
- 1962年4月 サーミスタ計測機器専業となり、名古屋市中区に名古屋営業所を開設
- 1963年2月 東京店頭登録株式公開
- 1963年12月 横浜市緑区に本社・工場を移転
- 1965年2月 東京都千代田区に東京営業所を開設
- 1971年3月 サーミスタ量産開始によりサーミスタセンサ販売開始
- 1975年10月 東京都渋谷区に東京営業所を移転
- 1977年5月 愛媛県松山市に中四国出張所を開設
- 1979年10月 札幌市東区に北海道出張所(札幌営業所)を開設
- 1980年10月 名古屋市千種区に名古屋営業所を移転
- 1981年2月 サーミスタ生産拠点として子会社東北タカラ・サーミスタ(株)を岩手県一関市に設立
- 1987年5月 広島市南区に広島営業所を開設
- 1987年7月 扶桑電機(株)を吸収合併
- 1989年4月 ニッポー(株)を吸収合併、同時に商号を(株)テクノ・セブンに変更
- 1990年1月 羽沢事業所(横浜市神奈川区 旧ニッポー(株)本社工場)内に新工場が完成し、本社・工場機能を集約し本社事務所を置く
- 1990年10月 子会社東北タカラ・サーミスタ(株)の解散決定し、新たに子会社(株)宝エンジニアリング(現 テクノ・トロン(株))を岩手県一関市に設立
- 1991年3月 東京営業所(東京都渋谷区)を千代田区外神田に移転統合
- 1993年1月 本店を羽沢事業所(横浜市神奈川区)に移転
- 1996年9月 横浜市緑区に鴨居事業所を開設
- 1997年6月 佐江戸工場(横浜市都筑区)を新設
- 1997年7月 本店及び本社機能を横浜市西区に移転
- 1998年5月 川和工場を横浜市都筑区に新設
- 2003年3月 東京コンピュータサービス(株)(現 TCSホールディングス(株))と資本・業務提携
- 2003年7月 鴨居事業所を本店(横浜市西区)に移転統合
- 2003年7月 子会社(株)タカラ・サーミスタの本店を横浜市港北区に移転
- 2003年8月 事務機器事業の製造を、東京コンピュータサービスグループの北部通信工業(株)に移管開始し、川和工場(横浜市都筑区)を閉鎖
- 2003年9月 東京コンピュータサービスグループのシステムウエア(株)(現 (株)テクノ・セブンシステムズ)(東京都千代田区)を子会社とする

沿革②



- 2005年10月 システムウエア(株)、商号を(株)テクノ・セブンシステムズに変更
2006年7月 温度計測器事業を、子会社(株)タカラ・サーミスタに譲渡
2006年9月 東京営業所(東京都千代田区)を東京都台東区に移転
2007年1月 本社機能を東京都台東区に移転
2007年7月 本店を東京都台東区に移転
2007年9月 事務機器製品販売会社として、子会社ニッポー(株)(東京都台東区)を設立
2007年9月 ソフトウェア関連事業開始
2008年1月 旧本社跡地(横浜市西区)に賃貸用マンション竣工
2010年1月 本社機能を東京都中央区に移転
2010年4月 ウインテック(株)(東京都中央区)を子会社とする
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に上場となる
2010年6月 本店を東京都中央区に移転
2010年7月 (株)タカラ・サーミスタ 温度計測事業を立山科学工業(株)に譲渡・業務移管
2012年4月 (株)タカラ・サーミスタ、商号をテクノ・トロン(株)に変更
2013年7月 大阪証券取引所と東京証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場となる
2014年4月 事務機器事業を会社分割(吸収分割)により、子会社ニッポー(株)が承継、事務機器の製造・販売をニッポー(株)に一体化
2015年4月 ウインテック(株)を吸収合併
2017年3月 本社機能を東京都世田谷区に移転
2017年4月 テクノ・トロン(株)を吸収合併
2017年7月 本店を東京都世田谷区に移転
2019年4月 (株)テクノ・セブンシステムズを完全子会社化

役員



代 表 取 締 役 社 長	齊 藤 征 志
取 締 役	亀 井 康 之
取 締 役	玉 越 雅 志
取 締 役	高 山 正 大

取 締 役（監 査 等 委 員）	成 田 耕 一
取 締 役（監 査 等 委 員）	吉 田 伸 也
取 締 役（監 査 等 委 員）	北 脇 俊 之

※当社は監査等委員会設置会社であります。

※北脇俊之は東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

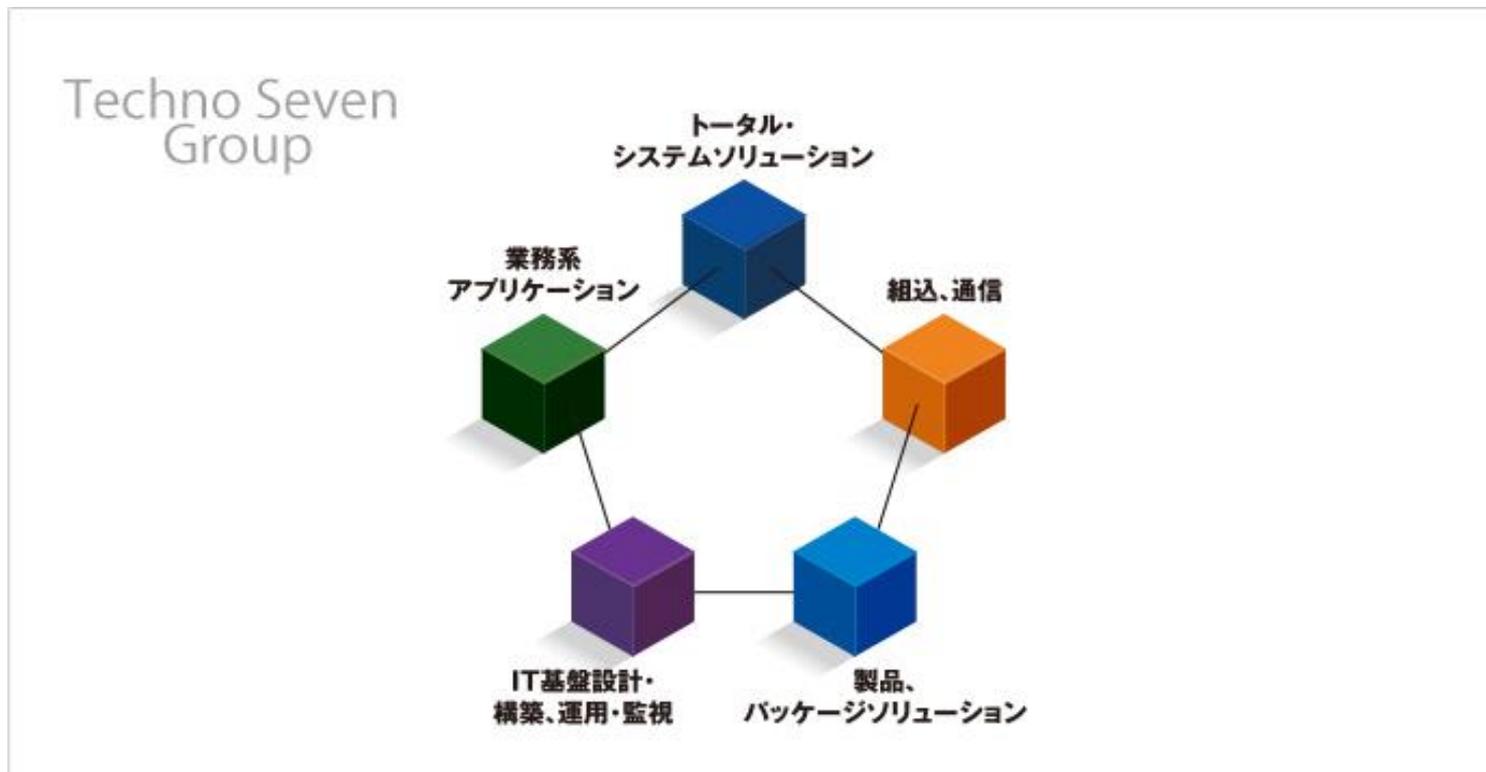
(2019年9月30日現在)

連結子会社の状況



名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	当社の所有 割合 (%)
(株) テクノ・セブンシステムズ	東京都 世田谷区	90	システム事業	100.0
ニッポー (株)	東京都 世田谷区	100	事務機器事業	100.0

(2019年9月30日現在)



テクノ・セブングループは、システム事業を手がけるテクノ・セブンとテクノ・セブンシステムズおよび事務機器事業を手がけるニッポーの3社で構成されていますが、各社が得意とする事業領域を明確にすることで、高い技術力・専門性を発揮する技術者集団となることを目指しています。グループ各社がきめ細かく連携することで、お客様の要望に応えるだけでなく、さらに『深化』した提案も行っています。今後は、ものづくりで培った技術力をベースに、製品の付加価値を高めるため、ネットワークや業務系のシステムをパッケージで提案するといった「エンドユーザーへのトータル・ソリューション」も提供してまいります。

システム事業

- ◆ 「システム・ソリューション」の提供や「組込系、制御系システムの開発」「ITインフラの構築・運用」を行う当社と、「業務系アプリケーション開発」を行う連結子会社の(株)テクノ・セブンシステムズの2社が、それぞれの強み、特徴を生かしながら連携し、最適なシステム・ソリューションをワン・ストップでお客様に提供します。

事務機器事業

- ◆ 連結子会社のニッポー(株)が、タイムレコーダー、3Dプリンタ、自動紙折り機など「NIPPO」ブランド製品の開発・製造・販売を行っています。3Dプリンタの分野では、ハードだけでなく、多様なフィラメント素材やユーザーフレンドリーなソフトウェアを提供し、トータルな3Dプリンタ・ソリューションを提案しています。

不動産事業

- ◆ 当社の所有するマンション・事業所施設の賃貸により安定的な事業収益をあげています。